



New !

<アプリケーションゾーンの概略ご説明>

電子機器トータルソリューション展

2024年6月12日(水)～ 6月14日(金)@東京ビッグサイト

 アプリケーションゾーンの設置 <small>(ゾーンへの出展をご希望の場合は、出展申込時にゾーンを選択してください。)</small>		
自動運転 自動運転向け高速伝送技術ゾーン	EV EV向け大電流技術ゾーン	パワー半導体 / ガラス基板 パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術ゾーン
アドバンスドパッケージ チップレット等の最先端半導体パッケージング技術ゾーン	気候変動対策 気候変動対策に寄与する低エミッション技術ゾーン	

※本資料で説明する企画内容は変更になる場合があります



アプリケーションゾーンへの出展 概要

<ご検討対象>

各ゾーンテーマのアプリケーションを支える技術に関連する製品やシステム、或いは評価/試験技術などを所有する企業、団体様

<ご出展いただく内容>

関連製品、技術をPR可能なパネル表示、現品設置（デモ動作）、来場者が触れる/体験できる特集など

※お申込み手続きについては出展要項等ご確認ください

※別途の説明を要望される場合にも、対応いたします。

Eメールにて運営事務局へお問合せ下さい show@jpca.org

電子機器トータルソリューション展 概要

プリント配線板や実装基板の国内外関係企業様からの出展を中心とした、エレクトロニクス業界をリードする技術や製品の産官学最新トレンド情報の発信、融合の場



＜構成展示会＞

- JPCA Show (JPCA主催)
- マイクロエレクトロニクスショー
- 実装プロセステクノロジー展
- メタバースデバイス展
- WIRE Japan Show
- Electronics Component & Unit Show
- E-Textile/Wearable展
- スマートセンシング
- 無人化ソリューション展
- エッジコンピューティング展

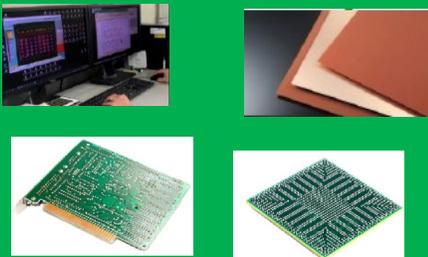
+

New! 2024
アプリケーションゾーン

欲しい技術がすぐ見つかる！ JPCA

アプリケーションゾーンの意図する展示領域

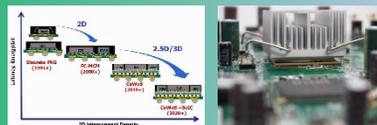
New! アプリケーションゾーン
最終製品を支える
部材、システム等に関連する
製造、技術、試験



従来出展対象：
プリント配線板、部品
実装他関連設備、
材料、資機材サプライ
ヤー 様 中心



例)
 ・CASE等車両支援技術、材料
 ・電子機器向け部品、制御技術
 ：パワー半導体/ガラス基板
 ：最新ICパッケージ関連技術
 ・環境負荷低減システム 等



セット/OEM製品



欲しい技術がすぐ見つかる！



アプリケーションゾーンへのご出展の魅力

☆来場者、他出展者への自社技術、製品のPR

☆セットメーカー来場者にもわかり易い

☆シームレスな出展構成による、新規ビジネスマッチング

☆若手技術者、学生様等への啓蒙への貢献



会場内でのレイアウト（イメージ）

＜会場中央付近に設置予定＞

アプリケーションゾーンは、各種展示会から独立した形で設定

※（イメージ）東展示棟4-6号館

（その他展示会）

アプリケーション
ゾーン

（その他展示会）



<各出展パートについて>



NEW

アプリケーションゾーンの設置

(ゾーンへの出展をご希望の場合は、出展申込時にゾーンを選択してください。)

自動運転	EV	パワー半導体 / ガラス基板
自動運転向け高速伝送技術ゾーン	EV向け大電流技術ゾーン	パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術ゾーン
アドバンスドパッケージ	気候変動対策	
チップレット等の最先端半導体パッケージング技術ゾーン	気候変動対策に寄与する低エミッション技術ゾーン	

※本資料で説明する企画内容は変更になる場合があります

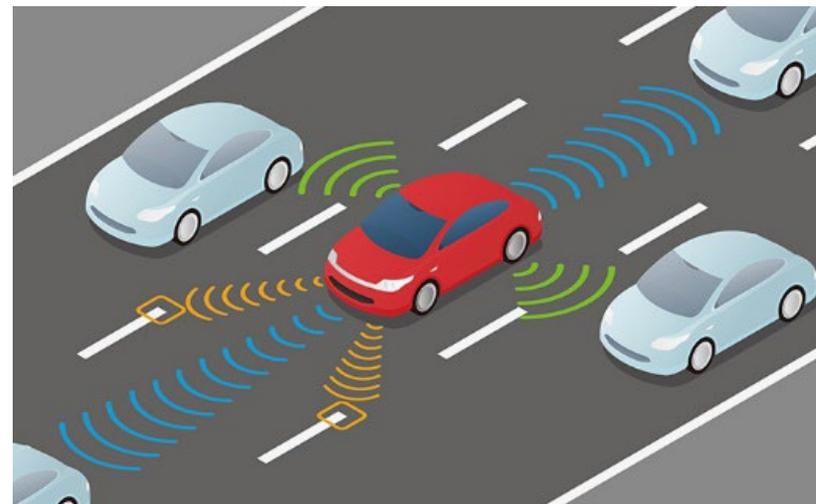
自動運転向け高速伝送技術 ゾーン

未来の自動運転を支える、革新的な高速伝送技術を紹介！

<テクノロジーの概要>

自動運転車両が様々なデータを高速かつ安定して伝送するための技術。

車両内でのデバイス間の信号伝送だけでなく、車両間通信（V2V）や車両と基地局との通信（V2I）などまでが含まれます。





自動運転向け高速伝送技術 ゾーン

<主な出展募集対象>

○高速、大容量データ通信

・低遅延通信、高解像度マッピング：

高精細な地図データを車両へ提供できる遅延の少ない通信技術
アンテナ等デバイス製品、材料

・リアルタイム通信：

高速情報処理を可能とする技術、センサー、他製品

○信頼性とセキュリティ

・データの完全性、安全性の確保：

自動運転車両へのデータのセキュリティを確保できるシステム、
装置の技術や製品など



EV向け大電流技術 ゾーン

未来のモビリティ、大電流で加速

<テクノロジーの概要>

EV（電気自動車）向けの大電流技術は、高速充電や高出力の駆動など、車両の電動システムにおいて大きな電流を制御・供給する要のテクノロジーとなります





EV向け大電流技術 ゾーン

<主な出展募集対象>

○高出力の駆動システム、制御システムの高度化

- ・ 大電流の安定制御と電池充電効率を最適化可能な技術、製品
- ・ 大電流による発熱への冷却技術関連

○高性能なバッテリー関連技術

- ・ 高性能LIB等、高エネルギー密度のバッテリー関連製品、技術
- ・ 電流ロスを最小限にする次世代技術や材料製品など

パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術 ゾーン

未来を冷却し、エネルギーを進化させる

<テクノロジーの概要>

発熱の大きいパワー半導体を用いた高性能電子機器やエネルギー変換システムにおいて、効率的なエネルギー変換、軽量で丈夫なエレクトロニクス機器の進展、等を支える材料技術、プロセス技術





パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術 ゾーン

<主な出展募集対象>

○高性能パワー半導体素子材料、基板材料

- ・ 高耐熱性、耐久性の半導体素材
- ・ 基板の軽量、剛性、柔軟性をもつ素材技術、製品
- ・ これを支える絶縁層用途のガラス基板材料技術、製品。

○微細加工技術の進化

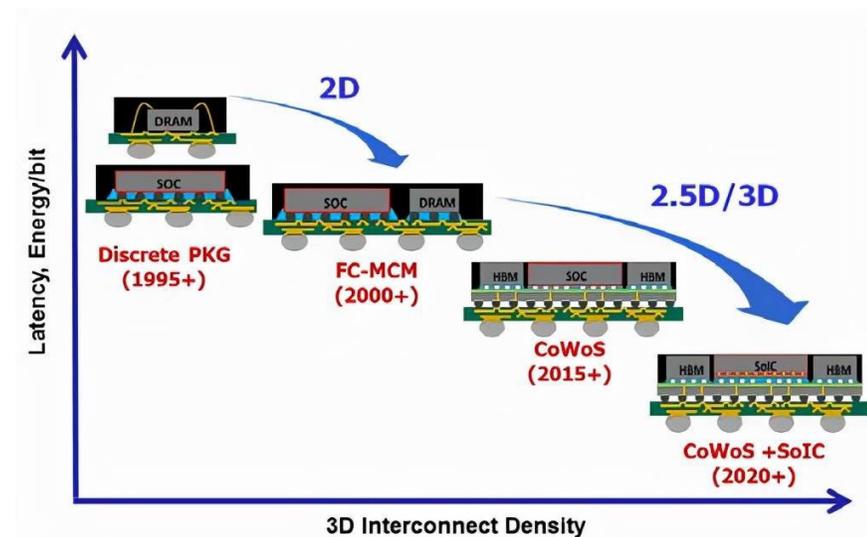
- ・ パワー半導体搭載用基板の微細パターンを形成できるプロセス技術、製品

アドバンスドパッケージング技術 ゾーン

半導体の未来を拓く、進化するパッケージングテクノロジー

<テクノロジーの概要>

昨今では限界を迎えつつあるシリコンウェハでの微細化技術をバックアップし、今後の半導体素子の性能進化を担保するための必要不可欠な技術。多種多様な形で技術進化を遂げている。





アドバンスドパッケージング技術 ゾーン

＜主な出展募集対象＞

○様々なSiP（システムインパッケージ）関連の要素技術、製品

- ・ 2.xD～3次元実装、PoP、WL-CSP、FO-WLP、チップレットなどの先進パッケージング技術
- ・ 関連するサブストレート、インターポーザ、プリント配線板技術、製品
- ・ 上記を支える素材製品（積層板、封止材料他）、プロセス技術等

気候変動対策・低工ミッション技術 ゾーン

低工ミッション、高効率。地球にやさしい未来へ

<テクノロジーの概要>

電子機器の進化において省エネルギー化や再生可能エネルギーの統合、製造プロセスのサステナビリティ、グリーンICTの導入など、これらの取り組みが総合的に進展することで、より環境に優しい電子機器が実現されています。





気候変動対策・低エミッション技術 ゾーン

<主な出展募集対象>

○超低消費電力デバイス、システム

- ・ 端末の効率的動作を支える消費電力をより削減できるデバイスの製品、関連技術
- ・ 通信機器やデータセンターの設計におけるエネルギー消費を最小限に抑えた情報通信技術の製品や技術

○サステナビリティ志向の電子機器製造プロセス

- ・ 省資源、省エネルギー設計、リサイクル材料や再生可能エネルギーの利用など、サステナビリティに配慮した製品、材料の製造プロセスなど
- ・ 環境モニタリングに活用される通信技術やセンサーテクノロジー関連製品、技術